

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響：

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	109 年度	108 年度	差 異	
			金 額	%
流動資產	\$ 44,590,593	\$ 43,342,833	\$1,247,760	2.88
投 資	928,313	1,527,238	(598,925)	(39.22)
不動產、廠房及設備	60,111,194	58,779,789	1,331,405	2.27
無形資產	1,002,475	1,059,626	(57,151)	(5.39)
其他資產	2,113,665	2,436,495	(322,830)	(13.25)
資產總額	108,746,240	107,145,981	1,600,259	1.49
流動負債	16,865,006	20,404,401	(3,539,395)	(17.35)
非流動負債	33,476,595	31,843,617	1,632,978	5.13
負債總額	50,341,601	52,248,018	(1,906,417)	(3.65)
股 本	7,791,466	7,791,466	0	0.00
資本公積	231,294	209,852	21,442	10.22
保留盈餘	38,561,679	35,447,618	3,114,061	8.78
其他權益	(366,982)	(324,741)	(42,241)	(13.01)
庫藏股票	(229,334)	(96,467)	(132,867)	(137.73)
母公司業主之權益	45,988,123	43,027,728	2,960,395	6.88
非控制權益	12,416,516	11,870,235	546,281	4.6
股東權益總額	58,404,639	54,897,963	3,506,676	6.39
重大變動項目分析說明如下：				
1.投資減少：主要係子公司投資之公司債到期所致。				
2.庫藏股票增加：主要係子公司購入本公司股票所致。				

註：上列財務資料來源為經會計師查核簽證之合併財務報告。

二、財務績效

(一)最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因：

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	109 年度	108 年度	增（減）金額	變 動 比 例 （ % ）	變動 分析
營業收入淨額	\$ 76,180,649	\$ 66,525,144	\$ 9,655,505	14.51	
營業成本	61,152,021	53,848,249	7,303,772	13.56	
營業毛利	15,028,628	12,676,895	2,351,733	18.55	
營業費用	4,310,458	3,964,655	345,803	8.72	
營業淨利	10,718,170	8,712,240	2,005,930	23.02	1
營業外收入及支出	(323,219)	(204,722)	(118,497)	(57.88)	2
稅前淨利(損)	10,394,951	8,507,518	1,887,433	22.19	1
所得稅費用	2,215,974	1,628,226	587,748	36.10	3
本期淨利	8,178,977	\$ 6,879,292	1,299,685	18.89	
增減變動分析：					
1.營業淨利及稅前淨利增加：主要係中美貿易戰及疫情影響，接單量增加所致。					
2.營業外收入及支出增加：主要係外幣兌換淨損失所致。					
3.所得稅費用增加：主要係稅前淨利增加所致。					

註：上列財務資料來源為經會計師查核簽證之合併財務報告。

(二)預期銷售數量及其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

世界半導體貿易統計(WSTS, The World Semiconductor Trade Statistics)預估 110 年全球半導體產品市場將持續成長，年增 8.4%，銷售額可達美金 4,694 億元。由工研院產科國際所的統計資料推估 110 年台灣 IC 產業產值約將成長 3.5%，達到美金 1,189 億元，顯示全球及台灣的半導體產業環境將可望持續成長。

依 IC Insights 資料，預估 110 年 IC 產業整體銷售額平均將上揚 12%。就 109 年全球十大半導體公司分析，記憶體與邏輯市場均較 108 年呈現大幅成長之勢。展望未來，隨著新興電子應用的興起，在人工智慧、5G、車輛輔助駕駛系統、資料中心、遠距教學及各式行動裝置的新功能推陳出新，預期半導體應用的領域與使用的數量在 110 年依然是持續成長。

在終端產品部分，受惠於 5G 需求帶動，集邦(Trend Force)預估 110 年全球手機之出貨量將成長至 13.6 億支，年成長 9%；Canalys 則預估全球個人電腦（包括桌機、筆電及平板）出貨量將因遠距工作及數位學習等因素成長至 4.64 億台，成長幅度為 1.4%。電子時報(DIGITIMES Research)預估伺服器市場受惠於遠距辦公及雲端服務需求，110 年將持續成長 5.6%，出貨量可達 1,700 萬台。

新冠肺炎(COVID-19)仍是影響各終端市場的最大不確定因素，市場復甦步伐的快慢取決於疫苗普及的速度。此外，因美國與中國間的貿易摩擦也將是影響整體產業發展的關鍵因素。

本公司預估在動態隨機記憶體(DRAM)、快閃記憶體(NAND Flash)、邏輯產品(Logic)及先進產品元件之銷售數量上將有所成長。

110 年預期銷售數量如下：

銷售項目	預計銷售數量
封裝	約 150 億顆
測試	約 92 億顆
凸塊(Bumping)	約 98 萬片
晶圓測試	約 260 萬片
固態硬碟(SSD) + 薄型固態硬碟系統整合封裝(SIP)	約 1.4 億顆

三、現金流量

(一)最近年度現金流量變動之分析說明：

單位：新台幣仟元

期 初 現金餘額	全年來自 營業活動 淨現金流量	全年來自 投資活動 淨現金流量	全年來自 籌資活動 淨現金流量	匯率變動對 現金及約當 現金之影響	現金剩餘 數額
21,800,048	19,301,292	(16,734,519)	(3,007,278)	(339,731)	21,019,812
109 年度現金流量變動情形分析：					
(1)營業活動：營業活動現金流入量主要係 109 年度獲利流入及折舊增加。					
(2)投資活動：投資活動現金淨流出量主要係 109 年度取得不動產、廠房及設備之現金流出。					
(3)籌資活動：籌資活動現金淨流出量主要係 109 年度發放股東現金紅利。					

(二)流動性不足之改善計畫：

109 年度現金流量無流動性不足之情形，故不適用。

(三)未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期 初 現金餘額	預計全年 來自營業 活動淨現 金流量	預計全年 來自投資 及籌資 活動淨現 金流量	現金剩餘 數額	現金不足額 之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
21,019,812	19,000,000	(18,500,000)	21,519,812	—	—
1.110 年度現金流量變動情形分析					
(1)營業活動：營業活動現金流入量主要係 110 年度預計獲利加計折舊等。					
(2)投資活動：投資活動現金淨流出量主要係預計 110 年度取得不動產、廠房及設備之現金流出。					
(3)籌資活動：籌資活動現金流出量主要係預計 110 年度支付股東股利及償還銀行借款之現金流出。					
2.預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

本公司 109 年度重大資本支出主要為取得不動產、廠房及設備，資金來源係以自有資金及銀行借款支付。由於本公司所處半導體產業之產品及技術世代交替迅速，需持續變更製程及研發新技術，並適時更新設備、擴充產能，以配合產品市場的變化及客戶的需求，以維持公司之競爭力。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計畫

本公司轉投資政策主要係為配合公司深耕本業，並以強化與主要客戶間之策略聯盟關係及延伸相關產業之營業觸角為方向，期以投資收益增進股東權益。本公司 109 年度轉投資之營運概況請詳捌、特別記載事項之關係企業相關資料內容。

本公司於 98 年度在投審會核准對大陸投資美金 51,000 仟元額度內，透過 Powertech Holding (B.V.I.) Inc. 間接投資力成科技(蘇州)有限公司(以下簡稱力成蘇州)，正式跨足大陸地區的封測領域。歷經超過十年的經營，力成蘇州在當地政府登記之投資總額為美金 2 億 1,600 萬元、註冊資本金美金 7,200 萬元。截至 108 年 12 月 31 日累積銀行短期借款金額已達美金 1,900 萬元、負債比率為 54%、累積虧損金額約為美金 5,400 萬元，已超過實收資本額之一半，財務結構及財務績效不甚理想。108 年以來，中美貿易戰及中國大陸政府持續推出獎勵半導體產業發展的政策，在鼓勵原有中國大陸業者將生產基地從海外移回中國大陸趨勢下，使得力成蘇州可望受惠。為掌握此機會，本公司於 108 年中由母公司指派經營團隊進駐力成蘇州以取代原團隊，除持續為其資金貸與及背書保證外，並於 109 年 4 月第八屆第 17 次董事會通過增加對力成蘇州之投資美金 2,800 萬元，其註冊資本金將由目前之美金 7,200 萬元增加至美金 1 億元，期望未來藉由新經營團隊、新產品及新客戶的加入，以促使營收規模漸趨擴大、生產成本得以下降，進而降低力成蘇州之營運成本並改善獲利與財務結構。

日本子公司力成科技秋田株式會社(Powertech Technology Akita Inc.) 於 106 年 8 月購自美光日本，因其承諾及自行開發之當地客戶訂單之營收，已無法支持其營運，基於長期營運規劃考量，於 109 年 8 月第九屆第 2 次董事會決議通過停止其營運，並授權董事長或其指定之人處理後續相關程序及作業。

新加坡子公司 Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd. 於 103 年 7 月購自 Nepes Corp. 主要從事 bumping 業務，因已開發客戶之營收，無法支持其營運，且於長期營運規劃考量，於 109 年 8 月第九屆第 2 次董事會決議通過停止其生產製造業務，仍將維持其公司主體作為控股公司，做為力成半導體(西安)有限公司及力成科技(蘇州)有限公司之控股公司，並授權董事長或其指定之人處理後續相關程序及作業。

未來一年投資計畫將視整體產業狀況與公司事業發展之需求，在鞏固策略聯盟合作關係與延伸相關產業營業觸角的方向下，經審慎評估後提報董事會核議。

六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1.利率變動之影響及因應措施

本公司所處半導體封裝測試業屬資本密集產業，機器設備的投資金額較大，資金來源除自有資金外，以銀行借款為主，故本公司損益受到利率變動之影響。對此風險本公司除定期評估銀行借款利率與市場平均利率之水準外，並適時向往來銀行洽商取得較優惠之借款利率。

2.匯率變動之影響及因應措施

(1)匯率變動之影響

本公司 109 年度外銷比重約為 79.85%，此為外幣收入之主要來源，幣別則以美元為主。而本公司部分機器設備及原物料亦從國外進口，大部份以美元或日幣計價，因此，不論收入或支出均受匯率波動之影響。本公司 109 年度匯兌淨損為 499,307 仟元。

(2)因應匯率變動之具體措施：

--進貨與收入產生相互沖抵之結果，使匯率之變動產生自然避險之效果。

--財務人員蒐集有關匯率變化之訊息，參酌往來銀行銀根鬆緊狀況，匯率走勢分析及市場外匯需求狀況，以作為因應匯率變動之參考。

--依據未來外幣需求情況下，適時買入外幣，以確定成本並降低匯率變動所造成之影響。

--運用銀行額度適當時機將外幣貸款轉換為新臺幣之借款。

--運用遠期外匯之衍生性商品交易，規避外幣計算之資產或負債及預期交易因匯率變動產生之風險。

3.通貨膨脹情形：

本公司 109 年度損益並無明顯受通貨膨脹之影響，未來將視變動情形因應調整。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

1.本公司並無從事高風險、高槓桿之投資交易。

2.依本公司背書保證處理程序規定，本公司得以公司名義對持股 50%以上子公司在一定限額內對其背書保證。為因應新加坡子公司 Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd.辦理短期借款所需，本公司於 103 年度提請董事會同意授權董事長在美金五千萬元之額度內，以公司名義對前述借款辦理背書保證。104 年度期間本公司已完成對該子公司之增減資，降低了該公司對銀行借款之需求額度，故於 105 年 3 月經董事會通過將背書保證限額調整為美金三千萬元。110 年 4 月止，該子公司因已清償債務而解除該背書保證。另外，同上述理由，本公司亦於 106 年 5 月 5 日第七屆第 20 次董事會決議通過對子公司力成科技(蘇州)有限公司之背書保證限額為美金二千萬元，109 年 8 月止，該子公司因已清償債務而解除該背書保證。

依本公司背書保證處理程序規定，本公司及子公司整體對單一企業背書保證責任之限額及對外背書保證總額，分別以不超過本公司淨值的 10%及 50%為限，本公司 109 年 12 月 31 日之淨值為 45,988,123 仟元，故本公司對單一企業背書保證責任之限額及對外背書保證總額分別為 4,598,812 仟元及 22,994,062 仟元，符合本公司背書保證處理程序及相關法令之規定。

- 3.為因應子公司擴充產能之資金需求，本公司於 108 年 5 月 3 日第八屆第 12 次董事會決議通過資金貸與力成科技(蘇州)有限公司及 Powertech Technology (Singapore) Pte Ltd.，金額分別為美金 2,400 萬元及美金 3,000 萬元為上限，並得分次貸與；貸款期間為一年，借款利率依借款當日銀行短期貸放利率計算，預計年利率約 0.57%~2.2%。力成科技(蘇州)有限公司於貸款期間皆未動支；而 Powertech Technology (Singapore) Pte Ltd.於 110 年 4 月底止，已全數清償所借貸之資金。

依本公司資金貸與他人作業程序之規定，有短期融通資金之必要之公司或行號，對個別對象資金貸與之限額及資金貸與總限額，分別以不超過本公司淨值的 5%及 10%為限。本公司 109 年 12 月 31 日之淨值為 45,988,123 仟元，故本公司對個別對象資金貸與之限額及資金貸與總限額分別為 2,299,406 仟元及 4,598,812 仟元，符合本公司資金貸與他人作業程序及相關法令之規定。

另外，本公司於 106 年 6 月初完成公開收購 Tera Probe Inc.成為子公司時，該公司原已資金貸與其 100%子公司 Tera Probe Aizu, Inc.，額度為日幣 8 億元，108 年 1 月經董事會決議降低額度為日幣 7.6 億元，截至年報刊印日止，實際動用金額為日幣 6.6 億元(約新台幣 169,422 仟元)。同上述資金貸與他人作業程序之規定，Tera Probe, Inc.109 年 12 月 31 日之淨值為 6,428,541 仟元(日幣 23,249,697 仟元)，故 Tera Probe, Inc.對個別對象資金貸與之限額及資金貸與總限額分別為 321,427 仟元(日幣 1,162,485 仟元)及 642,854 仟元(日幣 2,324,970 仟元)，亦符合本公司資金貸與他人作業程序及相關法令之規定。

- 4.本公司 109 年度及截至年報刊印日止，僅為規避以外幣計價之淨資產或淨負債因匯率波動所產生之風險而進行短期外匯交易，未從事投機性交易，因屬避險性質，故對本公司不會造成重大之獲利或虧損。

(三)未來研發計劃及預計投入之研發費用：

本公司自成立以來即致力於封裝測試人才的培訓，於 87 年即成立研發部門，持續進行封裝測試新製程、新技術之研發及引進；並於 95 年成立研發技術中心，未來將配合半導體記憶體主件朝多功能、高速化、高信賴度及高密度化方向發展及配合客戶新產品之開發情形，積極發展及引進新技術。未來研發計畫請詳伍、營運概況之一、(一)、4.計劃開發之新商品(服務)之說明。預計 110 年度投入之研發費用為新台幣 1,904,130 仟元，由於本公司編列研發費用之預算較為保守，實際執行結果應將與 109 年度相當。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司各項業務之執行均依照國內外重要政策及法律規定辦理，並隨時注意國內外重要政策發展趨勢及法律變動情形，以及時因應市場環境變化並採取適當的因應對策，而最近年度及截至年報刊印日止，本公司尚無受到國內外重要政策及法律變動而有影響財務及業務之情事。

(五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司所處半導體產業，產品及技術之世代交替迅速，為配合產品市場的變化及客戶的需求，需持續變更製程及研發新技術，並適時更新設備、擴充產能。為降低產能過度擴充之風險、有效運用資金掌握產品發展趨勢，本公司與主要客戶建立策略聯盟之合作關係，以共同提升先進技術之能力。另外，利用轉投資相關企業，佈建完整的產品線，藉以分散產業變化帶來的風險，並加強成本控制、現金管理來維持公司的競爭力，以控制對公司財務業務的影響。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司自成立以來，一向秉持專業及誠信之經營原則，持續積極強化公司內部管理及提升品質管理能力，並進一步增加客戶對公司之信任。本公司企業形象良好，近年並無企業形象改變而造成企業危機之情事發生。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司於 109 年及截至年報刊印日止，尚無進行併購之情形。

(八)擴充廠房之預期效益及可能風險及因應措施：

本公司為配合業務的擴展及持續先進封裝測試產品製程與技術開發的策略，近年來我們著力於面板級扇外型封裝(Fan-Out Panel-Level Packaging, FOPLP)技術及製程之研發，以提供客戶後摩爾定律之一解決方案。為建立此高階封裝製程之量產基地，於 107 年 9 月於新竹科學園區二廠所在地旁，面積 8,000 坪的土地上，開始動土興建地下二層、地上八層之新竹科學園區三廠，工程預計於 110 年下半年完工後開始裝機量產，預估未來將可提供約 3,000 多個優質的工作機會，以迎接物聯網、人工智慧、無人駕駛、高速運算及生技產業即將到來的需求，預期對未來營運之擴展將有所助益。本公司已於投資前持續評估各項擴建廠房可能產生之資金不足、工程進度落後、業務接單狀況等風險，並擬定相關措施，以降低各項風險對公司營運之不利影響。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

由於所處之產業特性，上游記憶體 IC 之市場集中度高，使得下游封測產業出現銷貨及進貨較為集中之現象，為分散此風險，本公司積極開發新客戶，與原有客戶建立友好的策略聯盟合作關係，並持續積極跨足非記憶體 IC 之封裝測試業務，目前在 DRAM、NAND FLASH 之記憶體及邏輯 IC 之封測代工呈現約略各占 1/2 之態勢。進貨方面，則積極尋找替代料及新合格供應商，以期使公司穩健成長。

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十二)訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者：

1.本公司重大訴訟、非訟或行政爭訟事件：無。

2.董事、監察人、總經理、實質負責人、持股超過百分之十之大股東及從屬公司重大訴訟、非訟或行政爭訟事件：無。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。